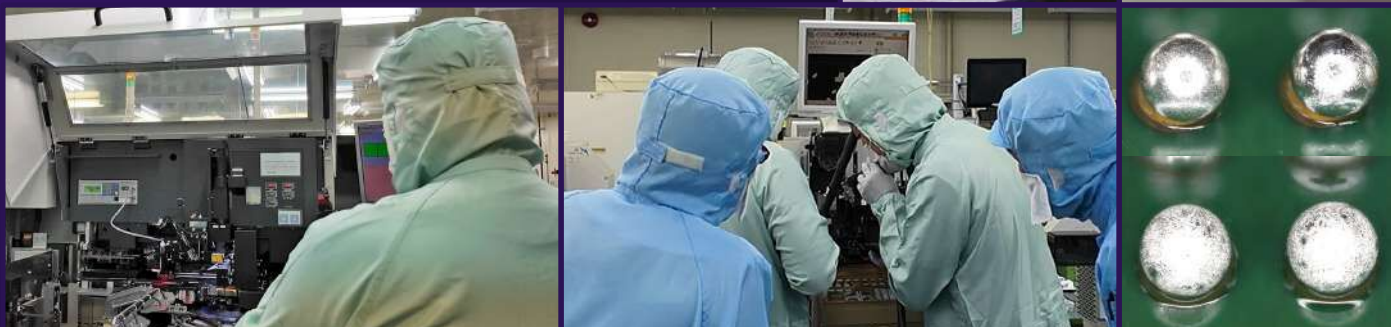
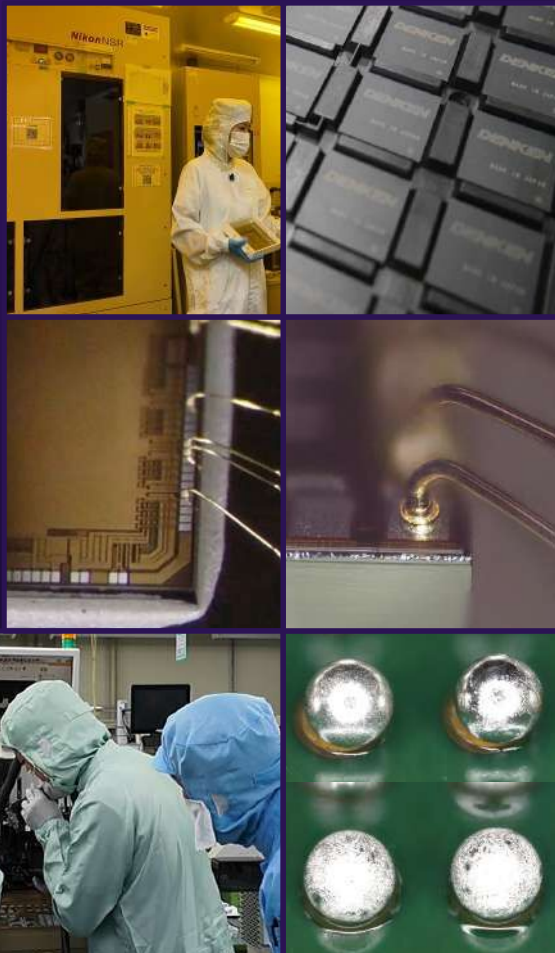


後工程の役割を、図や映像で学ぶ

# 半導体 後工程 の基礎

九州大学  
大学院システム情報科学研究所  
情報エレクトロニクス部門  
准教授 木野久志氏



2026年5月19日(火) 13:00~17:00

お申し込み期間: 2026年2月26日(木)9:00~2026年5月14日(木)17:00まで

受講料  
特別提供 **3,300円(税込)**

定員: 対面受講40名 / オンライン200名



- 対面受講会場  
福岡システムLSI総合開発センター  
2F 講義室  
住所 福岡市早良区百道浜3-8-33
- オンライン受講会場 Zoom Webinars  
(接続先リンクはお支払い完了後にご案内)



- お申込み方法  
ふくおかISTe-learningのホームページより、「講座・セミナー等 申込」をクリックし、「半導体後工程の基礎」の「対面受講申込」または「オンライン(OL)受講申込」を選択ください。

ふくおかISTe-learning

検索

本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。

e-mail : [reskilling\\_contact@ist.or.jp](mailto:reskilling_contact@ist.or.jp) TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団  
福岡半導体リスキリングセンター 事務局

- お申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です。 ■ お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません。
- 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります。 ■ 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止、又は延期する場合がございます。
- 会場にて全受講者に紙テキストを配布します。PDFテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)のダウンロードも可能です。 ※テキストの無断転載・複製等は禁止しています。

半導体製品が完成するまでの「後工程」について、前工程との違いから検査・梱包・出荷までの流れをやさしく解説します。工程の役割を図や映像で学ぶことで各工程の意味やパッケージの多様性が理解できます。先端パッケージ動向にも触れる、後工程理解の入門講座です。半導体業界の新入社員・若手技術者は元より後工程を把握したい初学者におすすめする講座です。

## 第1章 はじめに

- 1 「半導体」のイメージ
- 2 半導体製品の例
- 3 製品ができるまで
- 4 後工程の必要性
- 5 後工程（パッケージ）の種類
- 6 半導体パッケージの技術進化
- 7 アプリケーションに合わせた選択

※講座内容は一部変更になる場合がございます。

## 第3章 後工程プロセスの詳細 (実際の工程のビデオ映像で現場感を掴みます)

撮影協力：株式会社 デンケン

- 0 実装工程で行うこと
- 1 ダイソート
- 2 バックグラインド（裏面研削）
- 3 ダイシング
- 4 ダイボンディング  
※サンプル映像を  
YouTubeにて  
ご覧いただけます
- 5 ワイヤボンディング
- 6 モールドイング（樹脂封止）
- 7 マーキング
- 8 ボールアタッチ
- 9 パッケージダイシング
- 10 ピックアップ



## 第2章 後工程全体の流れ

- 0 後工程で行うこと
- 1 良品検査
- 2 チップ形状への切り出し
- 3 リードフレームへの接着
- 4 金属線で繋ぐ（ワイヤボンディング）
- 5 樹脂で封止
- 6 余分なフレームの除去
- 7 後工程の流れのまとめ

## 第4章 後工程パッケージの最新動向

- 1 後工程技術の進展
- 2 前工程側の課題
- 3 先端後工程技術による解決案
- 4 インターポーザの基材の種類
- 5 Si インターポーザ
- 6 Si インターポーザへの RDL 形成工程の例  
(ビデオ映像)
- 7 先端実装技術



2026年1月26日開催の同講座には  
300名を超える方にご参加いただき、アンケート  
でも大変高い評価をいただきました。



ここまで明瞭に撮影・整理された動画を拝見するのは初めてで、  
非常に分かりやすく、大変勉強になりました。

後工程を詳しく説明するような講座は少ないため、基礎から最新  
動向までわかりやすく説明いただき、大変理解が深まりました。

工程が一望できて非常によかった。詳細は、調べれば学べるが、  
このような概論はなかなか学べない。非常に貴重な講座だった。

定員  
各6名  
抽選制



クリーンルームに入室し、研究開発用設備の見学や  
サンプルの観察・測定を体験していただけます。

本講座の受講者を対象に、  
**無料の体験見学会を開催します**

2026年 ① 9:30～12:30…6名  
6月12日(金) ② 13:30～16:30…6名

会場：福岡超集積半導体ソリューションセンター

■応募は「受講後のアンケート」にて受け付けいたします。



福岡県内 中小企業の方は **受講料全額補助**



※消費税及び地方消費税を除く

詳細はこちら

補助には条件がございます。  
お申込みの前に福岡半導体  
リスクリングセンターのホーム  
ページから、申請要領・交付  
要綱をご確認ください。



公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団

福岡半導体リスクリングセンター